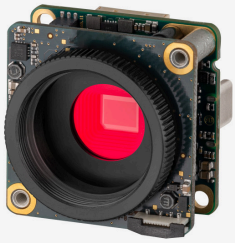
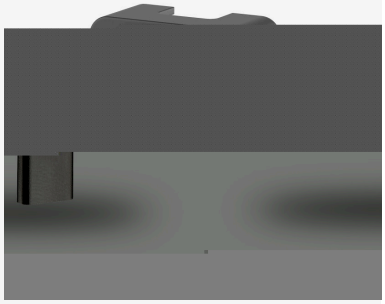
# U3-3044LE-M-GL-VU-AF Rev.1.2 (1008139)

■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



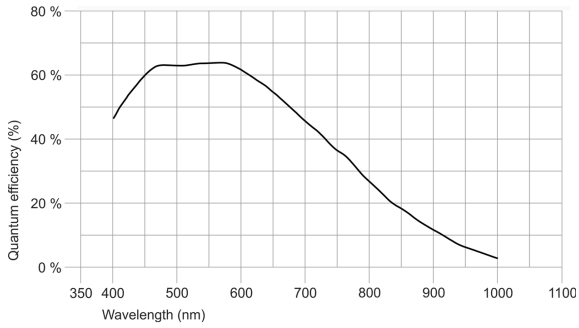




## 仕様

### センサー

| | |
|---|---|
| センサーのタイプ | CMOS モノクロ |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 特性 | リニア |
| 解像度/ピクセル | 1.6 MP |
| 有効画素数 | 1.58 メガピクセル |
| 有効画素数 (h x v) | 1456 x 1088 ピクセル |
| アスペクト比 | 4:3 |
| ADC | 12 bit |
| 色深度 (カメラ) | 12 bit |
| 光学センサークラス | 1/2.9'' |
| 撮像面積 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| 光学センサーの対角 | 6.25 mm 1/2.9″ |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| CRA (主光線角) | 0 ° |
| メーカー | Sony |
| センサーモデル | IMX273LLR-C |
| ゲイン (マスター/RGB) | 25.4x/- |
| AOI 水平 | 同じフレームレート |
| AOI 垂直 | 増加したフレームレート |
| AOI 画像の幅、ステップ幅 | 256 / 2 |
| AOI 画像の高さ、ステップ幅 | 1 / 1 |
| AOI 位置グリッド (水平/垂直) | 2 / 1 |
| ビニング水平 | 増加したフレームレート |
| ビニング垂直 | 増加したフレームレート |
| ビニング手法 | 水平: 加算 / 垂直: 加算 |
| ビニング係数 | 2x2 |
| デシメーション(サブサンプリング)水平 | 増加したフレームレート |
| デシメーション(サブサンプリング)垂直 | 増加したフレームレート |
| デシメーション(サブサンプリング)手法 | M/C 自動 |





T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

# U3-3044LE-M-GL-VU-AF Rev.1.2 (1008139)

## モデル

| | |
|---|---|
| フレームレートフリーランモード | 235 fps |
| フレームレートトリガー（連続） | 244 fps |
| フレームレートトリガー（最大） | 244 fps |
| 露出時間（最小～最大） | 0.022 ms – 2000 ms |
| 長時間露出（最大） | 30606 ms |
| 消費電力 | 0.8 W – 1.8 W |
| 画像メモリ | – |

## 環境条件

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。

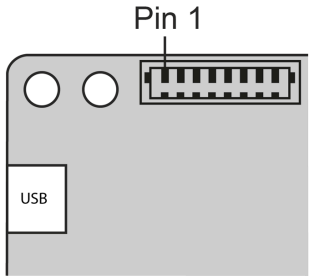
| | |
|---|---|
| 動作時の許容デバイス温度 | 0 ° C – 55 ° C / 32 ° F – 131 ° F |
| 保管時の許容デバイス温度 | -20 ° C – 80 ° C / -4 ° F – 176 ° F |
| 湿度（相対湿度、結露なし） | 20 % – 80 % |

## コネクター

| | |
|---|---|
| インターフェースコネクター | USB Type-C |
| I/O コネクター | Wuerth 製 10 ピンコネクター（WR-WTB 1.00 mm） |
| 電源 | USB ケーブル |

## ピン割り当て I/O コネクター

| | |
|---|---|
| 1 | 電圧出 力 5 V、最大. 400 mA |
| 2 | 接地（GND） |
| 3 | 汎用入出力（GPIO）2、3.3 V – Line 3 |
| 4 | 汎用入出力（GPIO）1、3.3 V – Line 2 |
| 5 | I2C クロック信号 – USB3 Vision ファームウェア 3.2 以上が必要 |
| 6 | I2C データ信号 – USB3 Vision ファームウェア 3.2 以上が必要 |
| 7 | オプトカプラなしのトリガー入力 3.3 V – Line 0 |
| 8 | オプトカプラなしのフラッシュ出力 3.3 V – Line 1 |
| 9 | 接地（GND） |
| 10 | 電圧出 力 3.3 V |




## 設計

| | |
|---|---|
| レンズマウント | CS- / C-マウントレンズ |
| 保護構造 | – |
| 外形寸法 | 36.0 mm x 36.0 mm x 26.0 mm |
| 重量 | 20 g |
| ハウジング素材 | – |

## Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。
このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

| | |
|---|---|
| 画像取得 | |
| Freerun | ✓ |
| Software trigger | ✓ |
| Hardware trigger | ✓ |
| Trigger controlled exposure | – |
| Denoiser | ✓ |
| Long exposure | ✓ |
| Line scan | – |


T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

| | | |
|---|---|---|
| フラッシュ | Flashing | ✓ |
| | PWM flashing | – |
| 画像調整 | Auto exposure | – |
| | Auto gain | – |
| | Auto whitebalance | – |
| | Color correction | – |
| | Gamma | – |
| | LUT | – |
| | Mirror/flip | X/Y |
| 統合画像処理 | Pixel formats | Mono8<br>Mono10<br>Mono10p<br>Mono12<br>Mono12p |
| | Region of interest | ✓ |
| | Decimation (FPGA) | ✓ |
| | Decimation (Sensor) | 2x2 |
| | Binning (FPGA) | – |
| | Binning (Sensor) | 2x2<br>Increases frame rate. |
| その他 | Chunks | – |
| | Sequencer | – |
| | Events | – |
| | Firmware update | ✓ |
| | 1st supported firmware version | 2.20 |



T.E.M. Incorporated

NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp